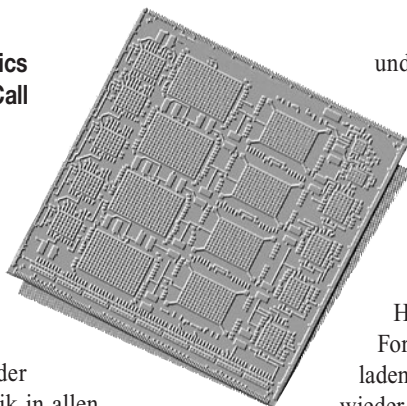




**International Microelectronics and Packaging society – Call for Papers**

Deutsche IMAPS Konferenz – Donnerstag 20. und Freitag 21. Oktober 2016, München  
 Im Herbst jedes Jahres veranstaltet IMAPS Deutschland eine Jahreskonferenz zu aktuellen Themen der Aufbau- und Verbindungstechnik in allen Anwendungsfeldern. Für die Sicherung, Stärkung



und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland möchte IMAPS Deutschland die Jahreskonferenz als eine wichtige Plattform für die dafür erforderliche engmaschige fachliche Diskussion zwischen Industrie und Hochschule sowie Produktion und Forschung verstanden wissen. Wir laden Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder herzlich ein, Ihre Ergebnisse zu den nachfolgend genannten mikroelektro-

**Tab. 1: Tagungsthemen**

<i>Entwurf, Modellierung, Simulation</i>	<i>Materialien und Prozesse</i>
Elektrisches und elektromagnetisches Design	Substratmaterialien und Oberflächenschichtsysteme
Thermisches und thermomechanisches Design	Herstellung von Verdrahtungsträgern
Fertigungs- und testgerechtes Design	Verbindungstechnologien (Flip Chip, CoB, SMT, Embedding, ...)
Aktuelle Schwerpunkte:	Schutz-, Verguss- und Verkapselungsprozesse und -materialien
HF Design und 3D-Entwurf	Aktueller Schwerpunkt: Nanomaterialien
<i>Technologien der Systemintegration</i>	<i>Qualität und Zuverlässigkeit</i>
Wafer Level Packaging (CSP, SiP, ...)	Prozessüberwachung / Teststrategien
Substrate Level Packaging (System on Board, Embedding, ...)	Prüfsysteme
MEMS / Sensor-Packaging	Thermomechanische Zuverlässigkeit
Optoelektronisches Packaging	Zuverlässigkeit bei kombinierten Beanspruchungen
Aktueller Schwerpunkt: 3D-Packaging	Aktueller Schwerpunkt: Lebensdauermonitoring und -vorhersage

nischen Packaging-Themen auf unserer Tagung vor Vertretern aus Industrie und Wissenschaft zu präsentieren und gemeinsam zu diskutieren (Vortragsdauer ca. 20 Minuten).

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum 15. Juni 2016 über das Onlinesystem im Internet-auftritt der IMAPS Deutschland: <http://www.imaps.de> Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben!

Kontakt: Dr.-Ing. habil. Markus Detert, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Mikro- und Sensorsysteme | Lehrstuhl Mikrosystemtechnik, Universitätsplatz 2, D-39106 Magdeburg

### ■ Internationale Konferenz für Hochttemperaturelektronik-HITEC 2016

Für den wachsenden Markt der Hochttemperaturelektronik haben sich zwei Konferenzen etabliert, zu denen sich Experten für diesen Spezialmarkt fachlich austauschen. Im jährlichen Wechsel sind die HITEC und HITEN zu einer Veranstaltungsreihe mit dieser spezifischen Ausprägung geworden. HITEC wird in den geraden Jahren veranstaltet durch IMAPS USA in Albuquerque, New Mexico, die britische Schwesterkonferenz mit Ausrichter IMAPS UK seit 2013 in Oxford und Cambridge.

In diesem Jahr findet HITEC vom 10. bis 12. Mai in Albuquerque statt. Die Veranstaltung spricht insbesondere Vortragende, Besucher und Aussteller aus einer Community an, die vom Materialhersteller über Halbleiterspezialisten für diese Chiptechnologien sowie Technologieanbieter für Elektroniksysteme und deren Packaging bis zu Fachleuten aus Forschung, Qualitätssicherung und natürlich Anwendern und Bedarfsträgern reicht.

Anwendungsbereiche wie Automobil, Industrieresensoren, Bergbau, Öl-/Gasbohrungen, Militär oder Chemische Verfahrenstechnik sind klassische Branchen, die spezielle Anforderungen an Elektronik stellen. Insbesondere dort sind Temperaturen von nicht selten deutlich über 200 °C gefordert, die mit herkömmlichen Technologien nicht zu zuverlässigen Systemen führen. Immer mehr gibt es auch Überschneidungen mit klassischen Bereichen, deren Applikationen in zunehmend rauerer Umgebungen arbeiten müssen und die demzufolge Interesse an hochtemperaturtauglichen Verfahren, Materialien und Prüfmethode haben. Die HITEC spricht neben der nahe liegenden „eigentlichen“ Elektronik auch Spezialisten aus Bereichen der Energieversorgung unter diesen Bedin-

gungen, Passivbauelemente, Datenübertragung, Substrat- und Gehäusematerialien sowie deren Zuverlässigkeitsbetrachtung an.

Aberundet wird die Konferenz durch einen vorgelagerten Professional Development Course am 9. Mai mit starkem Fokus auf geeigneten Materialien und Halbleitern für Hochttemperaturelektronik sowie Zuverlässigkeitsaspekten.

Interessenten finden auf der Website <http://www.imaps.org/hitec/index.htm> weiterführende Informationen

### ■ CICMT 2016 – Informationen für Kurzentschlossene

Die CICMT 2016 wird wenige Tage nach Erscheinen dieser Ausgabe der PLUS im Sheraton Denver Downtown Hotel in Denver stattfinden. Leider ist das endgültige Programm erst kürzlich fertig geworden. Für das vollständige Programm (mit Zugriff auf die Abstracts) soll hier auf die Website: <http://www.imaps.org/ceramics/> verwiesen werden. Folgende Beitragsreihen und Plenarvorträge sind vorgesehen:

#### *Dienstag, 19. April 2016:*

Keynote1: Dr. Wolfgang Wallnoefer (TDK): Lead-free Alternatives to PZT for Advanced Applications  
*Sessions:*

Direct Write and AM Electronics (4 Vorträge), Thick Film/Ceramic Sensors and Application (6 Vorträge), Power Electronics (6 Vorträge)

#### *Mittwoch, 20. April 2016:*

Keynote2: Franz Bechtold (VIA electronics GmbH): LTCC in the Field of Tension Between Academic Research and Industrial Application  
*Sessions:*

LTCC Integration and Materials (8 Vorträge), Microsystem Applications (5 Vorträge), Piezoelectric Materials and Applications (3 Vorträge), Ceramic Nanomaterials and Nanostructuring (3 Vorträge), High Temperature Electronics (3 Vorträge)

#### *Donnerstag, 21. April 2016*

Keynote3: Dr. Aric Shorey (Corning Inc.): Leveraging Glass for Advanced Packaging and IoT  
*Sessions:*

Microsystem Material and Properties (5 Vorträge), RF Packaging and Devices (5 Vorträge), Während der Konferenz wird eine Table-Top-Ausstellung stattfinden, die während der Pausen besucht werden kann.

## ■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Erlangen	14. April 2016	Frühjahrsseminar	IMAPS D, FAPS
Denver	19.-21. April 2016	CICMT	IMAPS US, ACerS
Albuquerque	10.-12. Mai 2016	HITEC 2016	IMAPS US
Grenoble	13.-16. Sept. 2016	ESTC	IEEE, IMAPS EU
München	20.-21. Okt. 2016	Herbstkonferenz	IMAPS D

## ■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der „International Microelectronics and Packaging Society“ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir drei Ziele: Wir verbinden Wissenschaft und Praxis, wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

## ■ Die Proceedings

Die Proceedings unserer Seminare und Konferenzen können auf CD zum Preis von € 55,- erworben werden.



Die aktuelle CD-ROM enthält ab April 2016 neben den Proceedings des diesjährigen Nürnberger Seminars auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind meist themenorientiert und beschäftigen sich zuvor mit zu

Themen wie ‚Volumenintegration: Stapeln-Falten-Vergraben‘, ‚Medizintechnik – Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen’s heiß – Power Electronic Packaging‘, oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘

*Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:*

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,  
Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St. Veit,  
Fax +49-8722-9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

## ■ Impressum

IMAPS Deutschland e. V.: 1. Vorsitzender:  
Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit  
und Mikrointegration (IZM),

Head of Dep.: System Integration  
and Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin  
Tel +49 30 46403-172 (-270 Sekr., Fax -271)  
martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de  
www.izm.fraunhofer.de

Schatzmeister (bei Fragen  
zu Mitgliedschaft und Beitrag):  
Ernst G. M. Eggelaar, ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen  
zu den Vorstandsmitgliedern  
finden Sie unter  
www.imaps.de (Vorstand)